

(주)퓨리오사에이아이

<https://furiosa.ai>



Unlock the next frontier of AI deployment with our NPU solutions

- 인공지능 반도체 시장에서 글로벌 1등이 되겠다는 목표
- GPU, CPU, 스토리지 솔루션, SoC, Performance Modeling, Verification 등 기술 보유
- 반도체 개발에 꼭 필요한 글로벌 수준의 역량 제공

NPU 반도체는 AI 고속 연산에 최적화된 차세대 전용 칩으로써 챗GPT 같은 초거대언어 모델과 스마트시티, 자율주행 등에 필요한 컴퓨터 비전 및 자연어처리, 추천 등 다양한 AI 모델들이 요구하는 AI 트랜잭션(연산)을 동시에 효율적으로 처리할 수 있는 능력을 갖춰야 한다. 퓨리오사에이아이는 창업 시점부터 이와 같은 S/W와 H/W를 모두 고려한 Co-Design을 기본으로 한 자체 방법론에 따라 칩과 컴파일러 등 풀 소프트웨어 스택을 개발해왔으며 이를 Warboy의 추가 Revision 과정 없이 One Shot으로 생산하고 상용 서비스까지 구현한다.

회사 개요	
설립일	2017.05.15
대표자명	백준호
직원수	100여명
업종/업태	비메모리용 및 기타 전자직접회로 제조업
기술분야	AI 반도체
메인아이템	AI 반도체
주요 구성원 소개	백준호 대표이사 AMD, 삼성전자(Georgia Tech 석사) 김한준 CTO 삼성전자(카이스트 박사) 구분철 CSE 삼성전자(서울대학교 박사)
소재지	본사 서울특별시 강남구 도산대로 145 연구 Office 251 Little Falls Drive, City of Wilmington

사업 Point



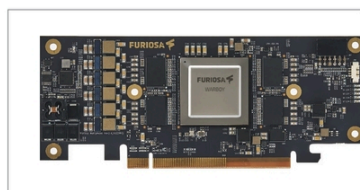
1세대 WARBOY CHIP



1세대 WARBOY 카드

AI 반도체를 개발하는 팹리스(Fabless) 반도체 업체

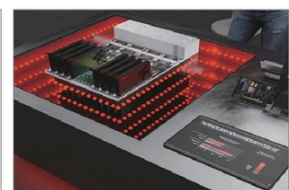
1. AI용 연산용 반도체 시장에서 기존 GPU(Graphic Processing Unit)를 대체할 차세대 반도체인 NPU 개발
2. AI 연산 최적화된(가장 적은 전력 소모로 가장 빠른 연산 수행) 칩 H/W 설계 기술 및 H/W 성능 실현 위한 SW 기술 종합 구축
- 실제 다양한 워크로드 환경에서 동작하는 칩 제작
3. 챗GPT 등 최근 AI 모델 특성은 거대화로 AI 반도체에 처리 요구하는 파라미터량이 폭증할 뿐 아니라 이를 고속으로 처리해야 함
- 이에 대응할 수 있는 HBM(High Band-width Memory) 같은 새로운 기술 도입과 저전력 설계
- 기존 GPU 기반 환경에 익숙한 개발자들이 불편 없이 사용할 수 있도록 S/W 환경까지 제공



WARBOY PCIe 카드



WARBOY 모듈



서버 모듈

주요 재무 현황



매출액				주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)			
2021	2022	2021	2022		
N/A	307,960천원	N/A	N/A	① 네이버랩스	
				② 카오엔터프라이즈	
				③ N/A	
				④ N/A	

투자 유치 이력		
투자 시기	투자자	투자금액(원/천원)
N/A	N/A	N/A

지식재산권 및 수상 현황



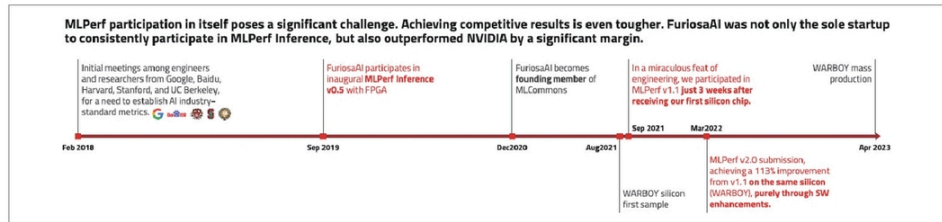
지식재산권		인증 및 수상내역
2022.02	뉴럴 네트워크 프로세서의 컨벌루션 연산 처리 방법 및 장치	2023.05 혁신아이콘 선정
2020.09	뉴럴 네트워크 프로세서	2021.11 과학기술정보통신부 장관 표창 수상
		2021.05 글로벌 ICT 미래유니콘 선정

핵심 기술력



개발 진척도 MLPerf 제출부터 2세대 칩 설계 완료까지

- 2020년 4월 1세대 칩(Warboy) 설계완료(삼성 14nm 공정, 디자인하우스 세미파이브)
 - 2021년 8월 Warboy 샘플 칩 확보(MPW)
 - 2021년 9월 Warboy MLPerf v1.1에 제출
 - 2022년 3월 Warboy MLPerf v2.0에 SW 개선만으로 성능 향상 결과 제출
 - 2022년 10월 Warboy 양산 칩 확보
 - 2022년 12월 Warboy 기반 클라우드 상용 서비스 제공(말해보자 영어사전 OCR 서비스)
 - 2023년 2월 2세대 칩(Renegade) 설계 완료(TSMC 5nm 공정, 디자인하우스 대만 GUC)
- ※ MLPerf: 구글, 메타, Nvidia 및 스탠포드 대학 등 글로벌 학계, 업계의 시리더로 구성된 컨소시엄으로 AI 반도체 시장에서 가장 공신력 있는 벤치마크 테스트 대회



혁신성 스펙, 가성비, 전성비 등 모두 우위에 있는 경쟁력

- 현재 AI 추론 시장에서 가장 많이 사용되는 N社 A2 및 이전 모델인 T4 대비 스펙상 경쟁력 확보
 - 가성비와 전성비(전력소모량 대비 성능) 측면에서도 우수
- AI 반도체에 필요한 풀스택 S/W 기술 직접 자체 개발
 - 가장 어려운 분야인 컴파일러에서는 세계적 경쟁력 보유
- 가격 경쟁력
 - N社 경쟁 제품 가격\$1,500~2,000 vs Warboy\$1,200로 가격경쟁력 보유
 - 전력 소모량 대비 성능에서도 78% 우수, TCO 측면에서도 경쟁력 확보